2023 -高密度電漿鍍膜與薄膜設計研討會

源 由：近年來因 AI 人工智慧晶片、量子電腦高速運算晶片、自駕車感測晶片與第三代高功率車用晶片的強大需求與快速成長下，帶動台灣半導體產業快速成長，成為全球半導體元件的生產重鎮。台灣在半導體製程與 IC 封裝技術上都有創新與嶄新的技術發展，更是需要真空鍍膜技術與薄膜模擬設計的技術支援，因此雲科大與國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心共同舉辦**高密度電漿鍍膜與薄膜設計研討會**，邀請國研院儀科中心、國立中央大學光電與工程學系、伸昌電機股份有限公司與宗豪科技股份有限公司等專家分別講授最新發展高能電漿鍍膜技術發展與應用，HiPIMS 高密度電漿在超硬薄膜技術開發，HiPIMS 電漿度膜系統組裝驗證，薄膜特性量測與 Macleod 薄膜設計等專業技術在半導體元件製程上所扮演的重要角色，希望參與研討會人員都能夠獲得高密度電漿鍍膜與薄膜設計的實務經驗。最後感謝國立雲林科技大學的**高教深耕計畫中心、教學卓越中心、電子工程系、國研院儀科中心**的支援。

時 間：112.09.06 (週三) 9:00 - 16:50

地 點：國立雲林科技大學 演講在工程五館 EB107 演講廳與上機實作在工程三館 ES302 電腦教室

主辦與協辦單位：國立雲林科技大學 (高教中心、教卓中心、電子工程系)、國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心

人 數：50 人

費 用：Free (中午供餐，素食請報名告知)

報名方式：9/4(一)PM17:00 報名截止，採網路報名。

報名網址：https://webapp.yuntech.edu.tw/Activities/Activities/Details?activityID=71625

聯絡人：高浩維 研究生 E-mail: m11113087@yuntech.edu.tw TEL:(05)5342601 ext 4373

議程時間表：

時間	單位	講員	講題
08:30-08:50	報到		
08:50-09:00	長官致詞		
09:00-10:30	台灣儀器科技研究中心/真空鍍膜與光學元件組	廖博輝/研究員	高密度電漿鍍膜技術發展與應用
10:40-12:10	國立中央大學/光電與工程學系	陳昇暉/特聘教授	HiPIMS 高密度電漿在超硬薄膜技術開發
12:10-13:00	午休 (用餐時間 ES102)		
13:10-14:40	伸昌電機股份有限公司/電子設備廠	林貞沅/副理	HiPIMS 電漿鍍膜系統建構與組裝
15:00-16:50	宗豪科技股份有限公司	蘇朝盈/講師	薄膜特性量測與 Macleod 薄膜設計軟體實作 (工程三館 ES302 電腦教室)